

**性能特点：**

- 频带：0.1~6GHz
- 小信号增益：18.6dB@1.9GHz
- 输入驻波：1.7
- 输出驻波：1.2
- 噪声系数：1.7dB@1.9GHz
- 输出 P-1dB：≥18dBm
- 供电：5V/54mA
- 芯片尺寸：0.9mmx0.65mmx0.1mm

**产品简介：**

HH-LN005060是一款工作在0.1~6GHz的高线性GaAs单片集成低噪声放大器。在1.9GHz处小信号增益为18.6dB,噪声系数1.7dB,输出P-1dB大于18dBm。可替代国外MINI-Circuits公司的GVA-63-D+。

该低噪声放大器芯片采用片上通孔金属化工艺，保证良好的接地。芯片背面进行了金属化处理，适用于共晶烧结工艺。该芯片适用于手机通信，微波组件等。

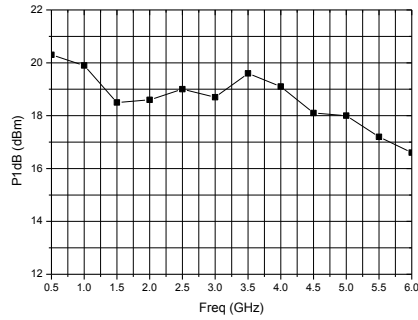
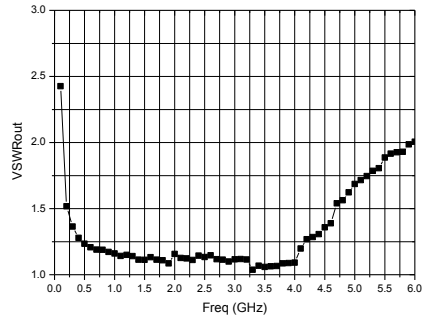
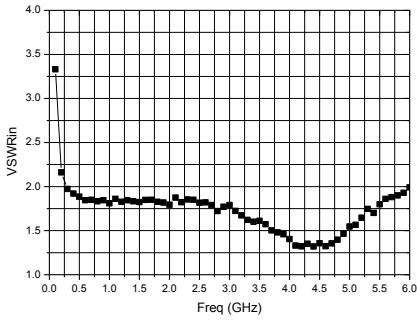
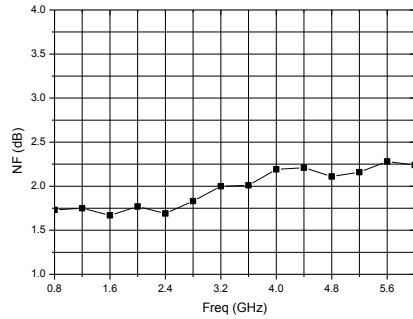
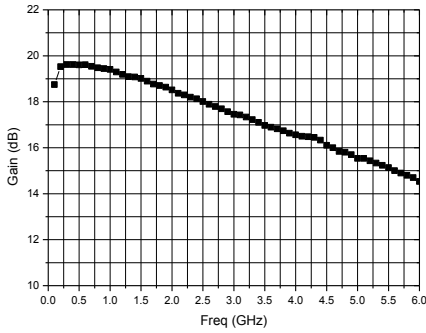
**电参数：** (TA=25°C, Vd=+5V, Id=54mA)

指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	0.1 ~ 6			GHz
小信号增益	14.5	18	20	dB
输入驻波	-	1.7	-	-
输出驻波	-	1.3	-	-
输出P-1dB	-	18	-	dBm
噪声系数	-	1.7	-	dB
工作电流	-	54	-	mA

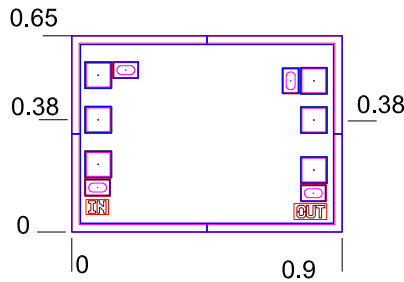
**使用限制参数：** (超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏。)

输入功率	+18dBm
漏极电压	+7V
漏极电流	90mA
存储温度	-65°C~150°C
使用温度	-55°C~125°C

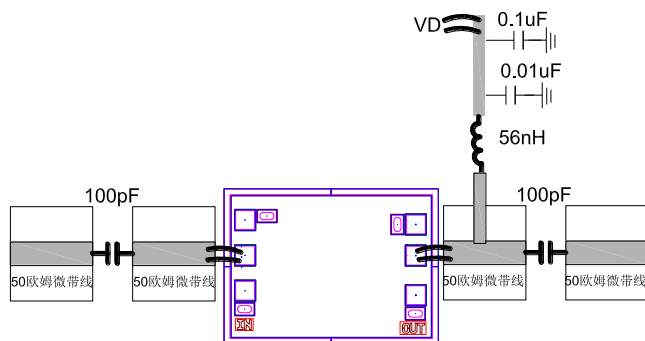
典型测试曲线：(TA=25°C, Vd=+5V, Id=54mA, )



尺寸图：(单位mm)



建议装配图：



使用说明：

**注意事项：**输入输出无隔直电容

**存储：**芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

**清洁处理：**裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

**静电防护：**请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

**常规操作：**拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

**装架操作：**芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

**键合操作：**输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。